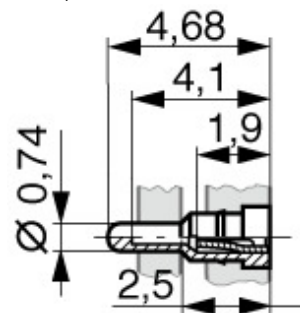
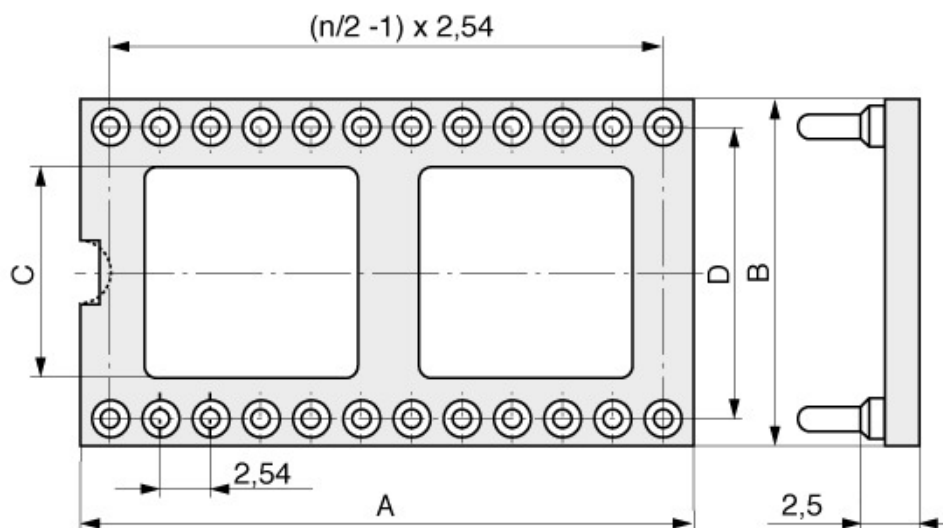


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Raster (mm) | 2,54 |
| Steckbar mit (von, bis) | ∅ 0,40-0,56 □ 0,25x0,45 |
| Polzahl | 8 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Sn |
| Isoliermaterial | Hochtemp. Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 3,0 A |
| Nennspannung | 150 V RMS / V DC |
| Durchschlagspannung | 1000 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 260°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | ⬇ Einlöt |
| Ausrichtung zu PCB | ⬆ Vertikal |
| Kontaktreihen | 2 |
| Reihenabstand (Code) | 300 mil |
| Kontakttyp | ULP 4,68 |



| | |
|-------------------------|----------------------|
| Veredelung Kontaktfeder | Au |
| Reihenabstand (mm) | 7,62 |
| Material Kontaktfeder | Beryllium Kupfer |
| Kontaktausführung | Gedreht |
| Sockellayout | ↔ DIL (Dual-in-line) |
| Typ | IC Sockel |
| Verpackung | Stange |
| A | 10,08 |
| B | 10,08 |
| C | 4,00 |





binder mpe GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
E-Mail: info@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **02.12.2025**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/ic-socket-carrier/ultra-low-profile-ic-socket-254-mm/004-1#004-1-008-3-D1STF-XTO>